

Tervetuloa O-johtavaan

Olemme ammattimainen piirilevyjen valmistaja, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus. Tuotevalikoima: yksipuolinen, kaksipuolinen, monikerroksinen piirilevy, joustava piirilevy ja MCPCB. Voimme tarjota nopean prototyypipalvelun: S / S 24 tunnissa, 4-8 yksikköä 48-96 tuotantotunnissa.

VÄHIMMÄISET KUPARIILYTYSEN REIKAT .025 AVG, .020 MIN .. reikiä EI voida kytkeä

Pakattu kirkkaalla kuplan väritöntä kalvoa, 25 kappaletta / pussi, aseta kuivausaine sivulle, aseta kosteusindikaattori päälle

Napsauta tätä saadaksesi lisätietoja: [Keraamisten piirilevyjen valmistaja Kiina](#)

Tuotteen Kuvaus

PCB P / N	Q503701-A
Laskevat kerrokset	2L
materiaali	BASE keramiikka
Yhtiön hallitus	0,55 mm
kupari thk	1/1 unssi
Pienin reiän koko	1.6mm
Reikien lukumäärä (kappaletta)	4
linja w / s	/
Impedanssitarkistus S / N (ToI%)	N
Pinnan viimeistely	Sähköhopea
Silkkihitsausmaski	vihreä
Yksinkertaiset mitat	Himmennetty X (mm): 109; Himmeä Y (mm): 50
Panelisation	Himmennetty X (mm): 109; Himmeä Y (mm): 50; UPS-nro: 1
Special: irrotettava naamio	N
Reititys / lävistys	CNC



www.o-leading.com

Keraamiset Flash Gold -tukukaupat

Tiimimme





sertifioinnit



201726 201VZL430354 - Wiring, Printed - Component



ZPMV2.E490354
Wiring, Printed - Component

For enhanced search functionality, please visit UL's [online family of databases](#).
Click on a product designation for complete information.

Page Bottom

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Components

O-LEADING SUPPLY CHAIN CO LIMITED 4190354

Fortune Building, Nanheng West Road
Room 1313
Huizhou, Guangdong 516211, CHINA

Type	Cond Width			SS/ DS/ Di	Area Diam	Solder		Temp		Flame	RoHS	C
	Min	Max	Min			Max	Class	DSR				
Hub/Bayer (mass laminate) printed wiring boards.												
D-LEADING-401												
	0.2 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	-	-
D-LEADING-407												
	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	D5	9.2 (0.4)	260	10	170	V-0	NI	-	-
Hub/Bayer printed wiring boards.												
D-LEADING-408												
	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) 31-135	D6	50.8 (2.0)	260	20	130	V-0	NI	-	-
Single layer printed wiring boards.												
D-LEADING-002												
	0.76 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	S5	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	NI	-	-
D-LEADING-003												
	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	S5	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-	-
D-LEADING-033												
	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	S5	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	NI	-	-
D-LEADING-205												
	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	NI	-	-
D-LEADING-206												
	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	D5	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	NI	-	-

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.
Last updated on 2017-01-27

Questions? Print this page Terms of Use Page Top

http://www.ul.com/onlinecertifications/201VZL430354/Wiring,Printed-Component



Test Report

No. CANEC1805164701

Date: 03 Apr 2018

Page 2 of 8

Test Results:

Test Part Description:

Specimen No. **SGS Sample ID** **Description**
SN1 CAN18-051647.001 Green "PCB"

Remarks:

- (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
- (2) MDL = Method Detection Limit
- (3) ND = Not Detected (< MDL)
- (4) "r" = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method: With reference to IEC 62321-4:2014+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC 62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Test Item(s)	Limit	Unit	MDL	Det
Cadmium (Cd)	100	mg/kg	2	ND
Lead (Pb)	1,000	mg/kg	2	9
Mercury (Hg)	1,000	mg/kg	2	ND
Hexavalent Chromium (CrVI)	1,000	mg/kg	8	ND
Sum of PBBs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Dibromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tribromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Pentabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Hexabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Heptabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Octabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Nonabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Decabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Sum of PBDEs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tribromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND



SGS is pleased to announce the launch of its new online certification platform, which provides a secure and efficient way for clients to manage their certification needs. The platform offers a range of services, including the issuance of certificates, the management of certificates, and the provision of technical support. For more information, please visit [www.sgs.com](#).

Member of the SGS Group (SGS SA)

Pakkaaminen ja toimitus

Pakkaus yksityiskohdat	Piirilevyjen ammattimainen valmistaja 16 vuotta (CERAMIC WAFER valmistaja Kiina)
Toimitustiedot	7-12 päivää



Ohje

1. Kuinka O-Leading takaa laadun?

Korkea laatustandardimme saadaan seuraavalla.

1. Prosessia valvotaan tiukasti ISO 9001: 2008 -standardien mukaisesti.
2. Ohjelmistojen laaja käyttö tuotantoprosessin hallinnassa
3. huipputekniset testityökalut ja työkalut. Esimerkiksi. Lentävä koetin, röntgentarkastus, AOI (automaattinen optinen tarkastaja) ja ICT (piirikoe).
4. Laadunvarmistusryhmä, joka on määritelty vikatapauksen analyysiprosessilla
5. Henkilöstön koulutus ja jatkuva koulutus

2. Kuinka O-Leading ylläpitää kilpailukyistä hintaa?

Viime vuosikymmenellä useiden raaka-aineiden (esimerkiksi kuparin, kemikaalien) hinnat olivat kaksinkertaistuneet, kolminkertaistuneet tai nelinkertaistuneet; Kiinan valuutan RMB vahvistui 31% suhteessa Yhdysvaltain dollariin; Ja myös työvoimakustannuksemme nousivat merkittävästi. O-Leading on kuitenkin pitänyt hinnat vakiona. Kyse on innovaatioistamme kustannusten vähentämiseksi, jätteen välttämiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi. Hintamme ovat erittäin kilpailukyisiä teollisuudessa samalla laadulla.

Uskomme molempien etujen mukaiseen kumppanuuteen asiakkaidemme kanssa. Kumppanuutemme

on molemminpuolista hyötyä, jos voimme tarjota sinulle edun kustannuksissa ja laadussa.

3. Millaisia kortteja O-Leading-prosessi voi tehdä?

FR4-yleiset, korkea-TG- ja halogeenittomat levyt, Rogers, Arlon, Telfon, alumiini / kuparilevyt, PI, jne.

4. Mitä tietoja tarvitaan piirilevyjen tuotantoon?

On parempi antaa tiedot Gerber 274-X-muodossa. Lisäksi Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP ja Eagle voidaan myös käsitellä.

5. Mikä on monikerroksisten piirilevyjen tyypillinen prosessivirta?

Leikkausmateriaali → sisäpuolinen kuivakalvo → sisäinen kaiverrus → sisäinen AOI → monisidos → päällekkäin menevät puristuskerrokset → poraus → PTH → pinnoitus → ulkoinen kuivakalvo → pinnoitus → ulkoinen kaiverrus → AOI → ulkoinen hitsausmaski → COD-komponentti → viimeistelypinta → reititys → E / T → Silmämääräinen tarkastus.